

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

796

ML4

Erstellt:

Bierlein, Tobias

Kunde:

Datum:

25.05.2018



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	65		2	
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	35	L2	3	
		200			
		35	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	65		4	
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	5	

Dicke nach Verpressen

B00:

390 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

440 µm

Dmin:

340 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

500 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

550 µm

Dmin:

450 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

418 µm

Version 1.2.18.12

© Würth Elektronik